

TG-A373F / L37-3F 导热硅胶片 Thermal Pad

REACH Compliant RoHS Compliant UL Comparable

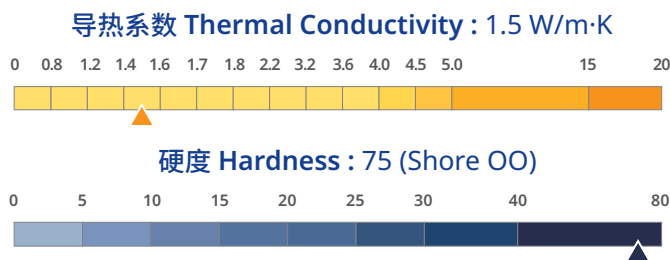
产品特性 Features

- 低延展率、不易变形
Low elongation
- 高绝缘性
Electrical insulation
- 操作性好
Easy to assemble
- 由硅胶、导热聚合物及玻璃纤维组成
Made from silicone, thermal conductive particles, fiberglass

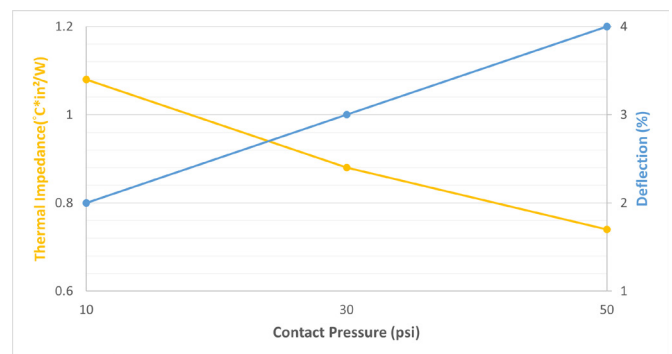
产品应用端 Applications

电子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

产品物性 Properties



压力, 热阻抗, 变形量示意图 Contact Pressure, Thermal Impedance, and Deflection



Properties	Unit	TG-A373F / L37-3F	Tolerance	Test Method
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	1.5	±10%	ASTM D5470 Modified
厚度 Thickness	mm	0.25/0.3/0.45	-	ASTM D374
	inch	0.0098/0.0118/0.0177	-	ASTM D374
颜色 Color	-	黄 Yellow	-	Colorimeter CIE 1976
补强材 Reinforcement Carrier	-	玻纤 Fiberglass Mesh	-	-
耐燃等级 Flame Rating	-	V-0	-	UL 94
耐电压 Dielectric Breakdown Voltage	kV	≥3.1/≥4.1/≥5.1	-	ASTM D149
重量损失 Weight Loss	%	<1	-	By T-Global
密度 Density	g/cm³	2	±5%	ASTM D792
工作温度 Operating Temperature	°C	-40~+200	-	-
体积阻抗 Volume Resistance	Ohm·m	>10 ¹¹	-	ASTM D257
延展率 Elongation	%	5	-	ASTM D412
抗拉强度 Tensile strength	kgf/cm²	150	-	ASTM D412
标准规格 Standard Format	-	单片状 Sheet	-	-
硬度 Hardness	Shore A	75	±7	ASTM D2240

※ 依选用厚度适用不同公差值 Different tolerances according to the selected thickness
 ※ 可依需求冲型裁切 Die-cut for different shapes

T-Global Technology Co., Ltd.

台湾 330058 桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 号

T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250325



注意：本技術からのデータ情報は t-global からの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することをしません。剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられません、特別な要望がなければ、t-global の評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売買する時には何か特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品が t-global とお互いに確認した invoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。